Spiral-MKIDs を用いた 2 次元テラヘルツ波イメージング Two dimensional imaging of terahertz waves using Spiral-MKIDs 山形大学¹^o倉科 大輔¹, 三上 直紀¹, 中島 健介¹, 齊藤 敦¹

Yamagata Univ.¹, ^oDaisuke Kurashina¹, Naoki Mikami¹, Kensuke Nakajima¹, Atsushi Saito¹

E-mail:tnw47532@st.yamagata-u.ac.jp

1. はじめに

近年、テラヘルツ波が電波の透過性と光波の直進 性を併せ持つ電磁波として注目されている。テラヘ ルツ波は、物質に対して同定性があり、医療・セキ ュリティ応用や物性研究、天文観測研究などへの利 用が期待されている。しかし、テラヘルツ波の2次 元リアルタイム分光はほとんど実現されていない。

我々は、同一のパターンでスパイラルアンテナと スパイラル型マイクロ波共振器の機能を併せ持つ Spiral-MKIDs を考案し[1]、 NbN 薄膜を用いること により、4K 冷凍機で動作するテラヘルツ波のリアル タイムの2次元分光の実現を目指している。

これまで、素子のアレイ化は最大 81 素子まで実現 されている。しかし、作製したどの素子においても 明瞭な 2 次元イメージングは実現できていない。こ の原因として、テラヘルツ波照射に伴う基板全体へ の熱伝播が考えられる。本研究では 9 素子アレイ Spiral-MKIDs を作製し、基板全体への熱伝播の影響 を調査し、抑制方法を明らかにしたので報告する。

2. 実験方法

サファイア基板上の NbN(3.5nm)を用いて Spiral-MKIDs の9素子アレイを作製し、GM 冷凍機 を用いて3.7 K及び2.1 Kまで冷却した。MKIDs の 通過特性(*S*₂₁)の測定にはベクトルネットワークアナ ライザを用いた。-50 dBm の信号をMKIDs に入力し、 出力を低雑音増幅器(LNA)で+35 dB 増幅させて通過 特性を測定した。

光照射時の基板温度の上昇による影響を確かめる 為に MKIDs の左半分をアルミテープで塞ぎ、基板と コールドヘッドの接着にインジウムシートとアピエ ゾンをそれぞれ使用し同様の測定を行った。MKIDs に対して、液体窒素に浸した電波吸収体を翳すこと によって、77 K (Cold)と 300 K (Hot)の熱輻射を照射 した際のマイクロ波特性の違いから共振周波数のシ フト量Δfcを求めた。ここで、遮蔽されて光が当たら ない左上の素子を KID1、光があたる右下の素子を KID9 とした。

到達温度を 3.7 K と 2.1 K に変化させ、光学チョッ パーを用いて素子に光を照射する事で素子の応答速 度を測定した。

2 次元テラヘルツイメージングには、計測・制御 システムのプログラミングツール Lab View を用いた。 それぞれの周波数を9分割された画面の1マスに対 応させて、信号強度の0から1の変化を色の強弱に 対応させることによってテラヘルツ波の照射を2次 元画像に変換した。

3. 実験結果及び考察

KID1 及び KID9 の共振周波数のシフト量 *Δf*cの比 を図 1 に示す。熱接触にインジウムを使用し 2.1 K まで冷却した場合に KID1 と KID9 の応答に約7倍の 差が確認できた。規格化出力の周波数依存性を図2 に示す。時定数関数を用いてそれぞれにフィッティ ングした曲線を細い実線で示し応答速度を求めた。 2.1 K では $\tau = 113 \mu s$ 、3.7 K では $\tau = 30 m s$ となった。 接着方法や到達温度を変える事によって共振周波数 のシフト量及び応答速度が変化したことから、基板 温度の上昇による変化と光の照射による量子的な変 化が同時に発生しているのではないかと考えられる。

次に、熱接触にインジウムを使用し 2.1 K に冷却 した状態で、光学系を調整し左半分に赤外線光を照 射した時の素子を赤外線カメラで撮影した結果を図 3 に示す。この時の MKID アレイによる 2 次元イメ ージング画面を図 4 に示す。光照射の有無に対応す る位置で明瞭なコントラスト像が得られた。

以上の結果より、熱コンタクトを改善することで 基板全体への熱伝播を抑制し、応答速度の向上及び、 明瞭な2次元イメージングの実現が可能であること がわかった。



Fig. 3 Infrared camera image. Fig. 4 Two dimensional image.4. 参考文献

[1] S. Ariyoshi, et al., *TEION KOGAKU*, Vol. 47, No. 9, pp. 554-561 (2012).